

ASMPT enabling the
digital world



SIPLACE TX micron

高速度和高精度的贴装支持子模块和SiP

SIPLACE TX micron

更快、更精准

先进封装和高密度应用的里程碑

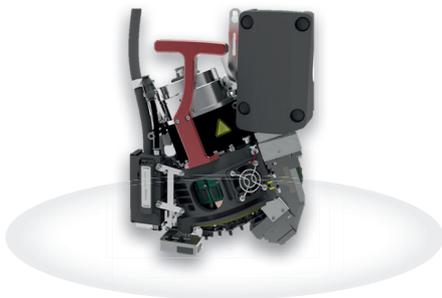
借助SIPLACE TX micron，您可以使用最先进的SMT技术（性能高达93,000 cph）和前所未有的精度运行先进封装和高密度应用。一台机器提供三个精度等级：20、15和10 μm @3 σ ，贴装间距可以小至50 μm 。SIPLACE TX micron的性能和可升级性保护了您的投资。

凭借智能功能，例如全新的高解析度PCB相机，灵活的多功能双轨选项，在带有SIPLACE料盘单元的JEDEC料盘中不间断供应元器件，开放接口标准和强大的控制软件，SIPLACE TX micron可以无缝地融入模块化，灵活和独立于制造商的开放式自动化概念，始终保证集成智能工厂的最大生产力和产量。

两种贴装头

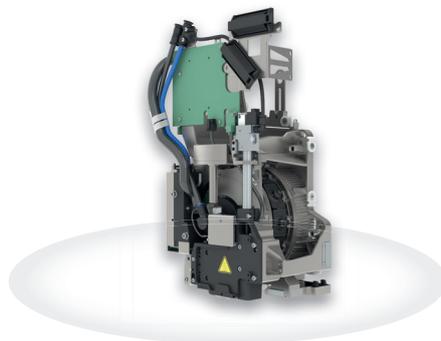
高精度和超柔性

整个贴装过程可以针对每个元件和贴装位置进行详细编程——包括非接触拾取和零压力贴装。



CP20P贴装头

- 元件范围：0201公制至 8.2 mm × 8.2 mm × 4 mm
- 适用于最敏感的元件：50 μm 的薄芯片（最小厚度）
- 速度极快：高达46,500 cph
- 精度极高：高达 $\pm 10 \mu\text{m}$ @ 3 σ



CPP贴装头

- 根据软件命令从拾取贴装切换到收集贴装再到混合模式
- 元件范围：0402公制至27 × 27 mm × 6 mm
- 速度快：高达23,850 cph
- 精度极高：高达 $\pm 20 \mu\text{m}$ @ 3 σ

最大的灵活性

供料与传输

- 坚固，智能和免维护的智能供料器，点胶供料器，压力验证供料器和线性浸渍单元2 x
- **全新：多功能双轨** 可以传输厚度达13.5毫米（含翘曲）的PCB。JEDEC盘，J-Boat，具有高定位pin的载具，或者“厚”载具都可以被传输。夹板和释放的速度是可编程的。

对于敏感元件： 最高精度



适用于敏感元件

可单独编程的贴装流程，提供非接触拾取和零压力贴装以及元件从料带到成品的元器件级追踪



裂晶/破晶检查

最低dpm率：图像处理系统甚至可以识别最微小的元件损坏和微小裂纹，而不会降低运行速度



蓝光和红光图像处理系统

甚至能处理最小元件（01005、0201m）的高对比度图片和特殊特征（铜柱凸块）的差异



最佳性能

借助双悬臂和创新的贴装模式，SIPLACE TX micron的性能高达93,000 cph



助焊剂检测/检查

使用涂蘸模块时光学控制可确保高产量



清洁室认证

7级认证
DIN EN ISO 14644-1和SEMI S2/S8



诸多创新： 设计精度

完美交互

SIPLACE TX micron有许多创新，它克服了传统的贴装精度限制。耐高温玻璃光栅尺、基准点、高分辨率光学传感器和创新真空治具的完美交互确保了极其精确的定位，同时提供了最佳性能。通过和最新的SIPLACE CA2组线，来自晶圆的主动器件和来自卷带的被动器件可以被同时贴装。通过消除编带、接料或续料，减少了工作量和人为错误，从而节省了成本。

SIPLACE料盘单元

通过紧凑机柜中的JEDEC料盘快速不间断地供料

关于SIPLACE TX micron的更多信息，请扫描



SIPLACE TX micron

SIPLACE TX micron	
速度(标称值)	高达93,000 cph
贴装精度(3 σ)	20 μm / 15 μm / 10 μm (可根据贴装位置和元器件等级选择)
PCB尺寸(长x宽)	50 mm x 45 mm至375 mm x 460 mm (单轨模式) 50 mm x 45 mm至375 mm x 260 mm (双轨模式) 50 mm x 45 mm至590 mm x 460 mm (长板选项) 50 mm x 55 mm至300 mm x 240 mm (真空传输 / 15 μm) 50 mm x 55 mm至250 mm x 100 mm (真空传输 / 10 μm)
机器尺寸(长x宽x高)	1.00 m x 2.23 m x 1.45 m
元器件供应	达80个8-mm供料器, JEDEC制式料盘,线性浸渍单元, 点胶供料器, SIPLACE料盘单元, 第三方供料器集成, JTF-ML2
功耗(平均)	带有CP20的SIPLACE TX2i micron为2.0kW(带有CPP的SIPLACE TX2 micron为1.2kW)
耗气	120 NI/min (2个CP20贴装头)
认证	Semi S2/S8, 洁净室ISO 7级
数据接口	IPC-HERMES-9852、IPC-CFX、IPC-SMEMA-9851

贴装头	CP20	CPP
速度(标称值)	高达46,500 cph	高达23,850 cph
元件范围	高达8.2 x 8.2 mm*	高达27 x 27 mm**
贴装精度(3 σ)	高达10 μm	高达20 μm
最小引脚间距	70/50* μm	120 μm
最小引脚宽度	30/25* μm	50 μm
最小锡球间距	100/50* μm	140 μm
最小锡球直径	50/25* μm	70 μm

* 配备可选蓝光高分辨率照相机 (SST49) / ** 配备可选高分辨率照相机 (SST30)

先进封装技术合作伙伴

先进封装是当今电子产品生产中的关键技术之一，它模糊了半导体生产/OSAT、IDM和严苛的SMT应用之间的界限。在时间、成本和效率压力不断上升的时代，SiP和SoC的生产以及在高精度SMT平台上芯片和倒装芯片模块的加工变得日益普遍。借助SIPLACE TX micron，您可以在先进封装和高密度应用中使用最

先进的SMT技术，以取代效率低得多的键合方案。作为全球最大的电子行业供应商，ASMPT既为半导体生产商和OSAT的后道部门，同时也为传统的SMT生产设施提供服务。新型SIPLACE TX micron的开发基于数十年的经验和这两个领域的最新技术，将先进封装和高密度应用提高到新的生产力水平。

ASMPT

先进装配系统有限公司

上海市东育路227弄3号前滩世贸中心二期C栋3层 | 电话: +86 21 58873030 | E-mail: smt-solutions.cn@asmpt.com

🌐 asmpt.com | 🌐 smt.asmpt.com

6/02-2025版 | 保留所有权利 | 订购号: A22-ASMPT-A316-ZH | 中国印刷 | ©ASMPT GmbH & Co.KG

本手册中的所有信息和插图均以“概不保证”的方式提供，不含任何明确或隐含的担保，包括但不限于对质量满意、适用于特定用途和/或正确性的隐含担保。

本手册的内容仅供参考，不构成建议，如有更改，恕不另行通知。ASMPT在法律允许的最大范围内，对本手册中包含的内容、细节、规格或信息的正确性、准确性、充分性、实用性、及时性、可靠性或其他方面的使用不作任何保证或声明。请联系ASMPT以获取最新信息。仅在达成协议的情况下，特定性能特性和/或功能才具有法律效力。

所有产品名称均为ASMPT或其他供应商的品牌或者商标。第三方使用需经所有者授权。